



기종명

# APX300 (Dicer Modular)

Plasma Dicer

품번: NM-EFE4AA-D

- 웨이퍼 전면을 손상 없이 일괄적으로 Dicing하여 강도 높은 Chip 분할을 실현합니다.
- Panasonic의 독자적인 프로세스로 다양한 종류의 반도체 웨이퍼를 Dicing할 수 있습니다.
- 생산량에 맞추어 싱글 챔버 시스템에서 멀티 챔버 시스템(\*1)으로 전개가 가능합니다.

기종명	APX300 (*2)
품번	NM-EFE4AA-D
플라즈마 원	ICP 플라즈마
프로세스 가스	표준 4계통 (최대 6계통까지 증설 가능: 불소계 가스, Ar, O <sub>2</sub> , He 등)
처리대상웨이퍼	표준 φ200 mm, 혹은 φ300 mm (링 프레임 포함) *1
설비크기	W 1,350 mm × D 2,230 mm × H 2,000 mm *2 (싱글 챔버 시스템(옵션 반송 유닛 연결 사양)) *3
설비무게	2,330 kg (장치 구성에 따라 상이할 수 있습니다.)
전원	3성 AC 200 / 208 / 220 / 230 / 240 *4 ±10V, 50 / 60 Hz, 21.0 kVA
공압원	0.5 MPa ~ 0.7 MPa, 250 L/min (A.N.R.)
N <sub>2</sub> 원	0.1 MPa ~ 0.2 MPa, 50 L/min (A.N.R.)

\*1: 기타 사이즈의 웨이퍼에 대해서는 별도 문의주시기 바랍니다.

\*2: 터치 패널, 조작 패널, 시그널 타워, 배관 등의 돌출부 및 드라이 펌프, 칠러 등의 주변 기기는 포함되지 않은 사이즈입니다.

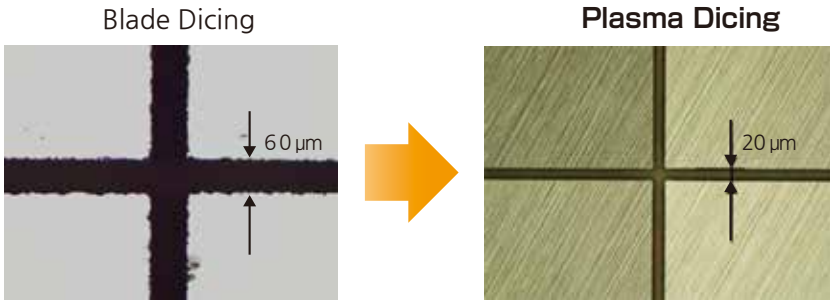
\*3: 반송 유닛(옵션)은 전용 카세트로의 진공 로드 공급 사양입니다.

\*4: 3상 전원은 2계통이며, 그 합계를 나타냅니다. 드라이 펌프, 칠러 등 주변 기기는 포함되어있지 않습니다.

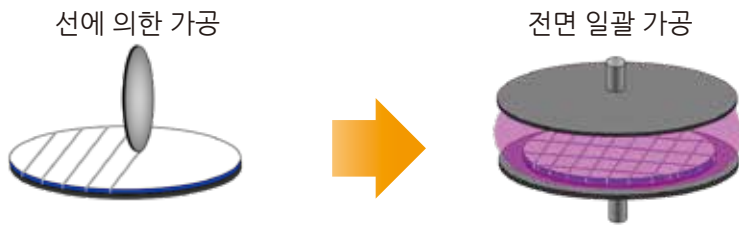
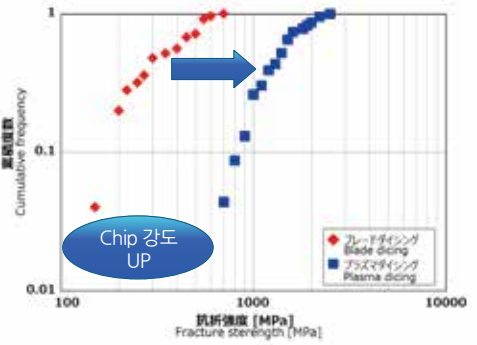
\*1: 당사 지정 반송 기기와의 연결이 필요합니다. 자세한 사항은 별도 문의주시기 바랍니다.

\* 자세한 내용은 사양설명서를 참조해주시기 바랍니다.

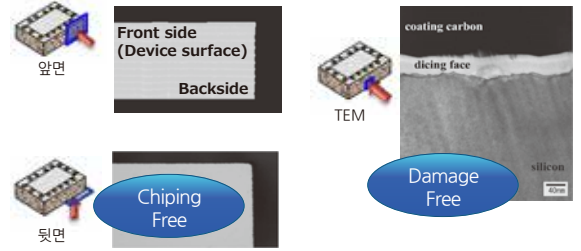
Chip의 취득 수 증가·전면 일괄로의 고속 가공      Chip 강도 향상



Dicing 폭 최소화

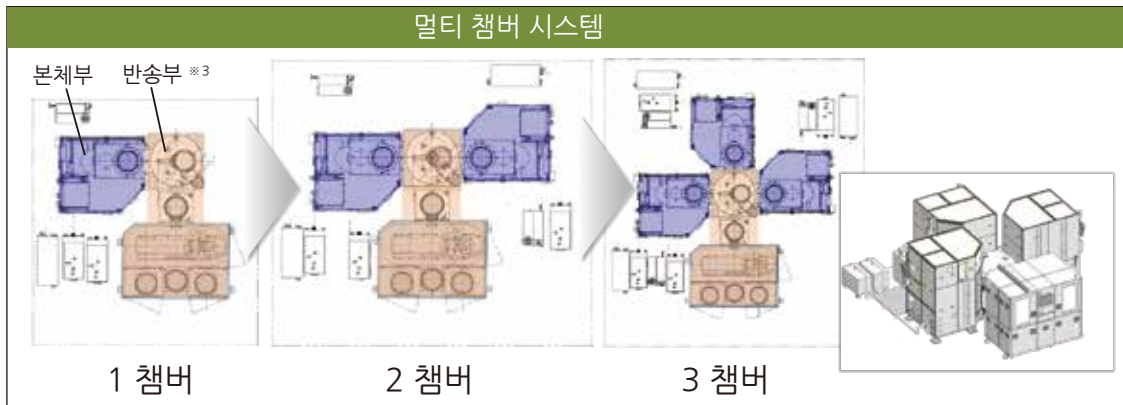
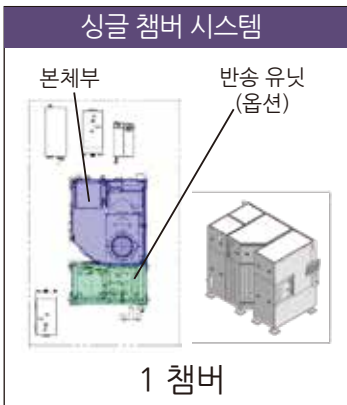


웨이퍼 전면 일괄 Dicing



Damage-free Dicing

고객의 생산 규모에 유연하게 대응  
 - 싱글 챔버 시스템에서 멀티 챔버 시스템으로 전개 가능 -



※3: 당사 지정 반송 기기와의 연결이 필요합니다. 자세한 사항은 별도 문의해주시기 바랍니다.

**⚠ 안전에 관한 주의사항**

- 제품을 사용하실 때에는 반드시 취급설명서를 숙지한 후 올바른 방법으로 사용해주시기 바랍니다.
- 본 카탈로그에 기재된 제품의 안전한 사용을 위해 설비의 가동·정지에 관계 없이 설비에 첨부된 취급설명서 및 설비에 부착된 경고 문구를 충분히 확인하신 후, 올바른 조작을 해주시기 바랍니다.

Panasonic은 친환경 제품 만들기에 최선을 다 하고 있습니다.

자세한 사항은 아래의 홈페이지에서 확인해주시기 바랍니다.  
<https://holdings.panasonic/global/>



문의 사항 기재란

**Panasonic Connect Co., Ltd.**  
 Process Automation Business Division

3-1-1 Inazu-cho, Toyonaka City, Osaka  
 561-0854, Japan

본 카탈로그의 기재 내용은  
 2022년 4월 1일 기준입니다.

Ver.2022.4.1

© Panasonic Connect Co., Ltd. 2022